

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业

公告编号：2021-005

上海硅产业集团股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、前次募资资金的募集及存放情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年3月17日出具的证监许可[2020]430号文《关于同意上海硅产业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，上海硅产业集团股份有限公司获准向社会公众公开发行人民币普通股620,068,200股，每股发行价格为人民币3.89元，股款以人民币缴足，募集资金总额计人民币2,412,065,298.00元，扣除含增值税承销保荐费用人民币111,722,938.41元后，本公司实际收到募集资金计人民币2,300,342,359.59元。募集资金总额扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他上市交易费用共计人民币127,675,510.47元（不含增值税）后，本公司募集资金净额共计人民币2,284,389,787.53元，上述募集资金于2020年4月15日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字(2020)第0303号验资报告。

于2020年9月30日，募资资金在专项账户中的余额为人民币18,130,571.56元。具体情况如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行	账户名称	账号	存款方式	余额
上海银行嘉定支行	上海硅产业集团股份有限公司	31981303004092577	活期	267,608.60
中国银行上海市张江高科技园区支行	上海硅产业集团股份有限公司	446879415963	活期	40,566.68
招商银行上海华灵支行	上海新昇半导体科技有限公司	121921770510686	活期	17,822,396.28
总计				18,130,571.56

二、前次募资资金使用情况

根据公司 2020 年发行人民币普通股招股说明书，计划对 2 个具体项目使用募集资金人民币 2,500,000,000.00 元。截至 2020 年 9 月 30 日止，本公司实际投入所涉及使用募集资金项目款共计人民币 1,569,830,130.68 元，详见附表一《前次募集资金使用情况对照表》。

三、前次募集资金变更情况

截至 2020 年 9 月 30 日止，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

2020 年 5 月 29 日，公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司独立董事发表了明确的同意意见，同意公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 58,296.79 万元，以自筹资金支付部分发行费用为人民币 1,449.52 万元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金预先投入的使用情况出具了《上海硅产业集团股份有限公司截至 2020 年 5 月 29 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字(2020)第 2454 号）。截至 2020 年 9 月 30 日，上述募集资金全部置换完毕。

五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

本公司在 2020 年首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未对募集资金的使用效益做出任何承诺，因此前次募集资金投资项目实现效益情况对照表不适用。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

七、闲置募集资金的使用

公司为提高募集资金使用效，将部分暂时闲置募集资金通过结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理，投资产品的期限不超过 12 个月。

2020 年 4 月 27 日，公司第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第七次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，拟使用额度不超过 150,000 万元（包含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事发表了明确的同意意见。

截至 2020 年 9 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 704,100,000.00 元。公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

金额单位：人民币元

受托方	类型	金额	认购日	到期日	收益类型	年化收益率	是否到期
上海银行嘉定支行	7 天通知存款	4,100,000.00	2020.06.18	滚存	保本固定收益	2.0250%	不适用
招商银行上海华灵支行	结构性存款	100,000,000.00	2020.07.13	2020.10.13	保本浮动收益	3.0300%	否
招商银行上海华灵支行	结构性存款	100,000,000.00	2020.07.15	2020.10.15	保本浮动收益	3.0000%	否
招商银行上海华灵支行	结构性存款	100,000,000.00	2020.07.22	2020.10.23	保本浮动收益	2.9300%	否
招商银行上海华灵支行	结构性存款	100,000,000.00	2020.09.01	2020.12.01	保本浮动收益	2.9300%	否
招商银行上海华灵支行	结构性存款	100,000,000.00	2020.09.07	2020.12.07	保本浮动收益	2.9300%	否
招商银行上海华灵支行	结构性存款	200,000,000.00	2020.09.14	2020.12.14	保本浮动收益	2.9500%	否
合计		704,100,000.00					

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2020 年 9 月 30 日，公司前次募集资金累计已使用人民币 1,569,830,130.68 元，完成前次募集资金净额的比例为 68.72%，募集资金账户余额为人民币 722,230,571.56 元（包含利息收入 7,685,343.98 元，扣除手续费 14,429.27 元），其中现金管理余额 704,100,000.00 元，全部为银行短期保本型结构性存款和 7 天通知存款。前次募集资金账户余额将继续用于募集资金投资项目。

九、前次募集资金使用的其他情况

无。

十、上网公告附件

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海硅产业集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2021年1月13日

附表一：《前次募集资金使用情况对照表》

截至 2020 年 9 月 30 日止本公司前次募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币元

募集资金总额：			2,284,389,787.53			已累计使用募集资金总额：			1,569,830,130.68	
变更用途的募集资金总额：			-			各年度使用募集资金总额：			1,569,830,130.68	
变更用途的募集资金总额比例：			-			2020 年 1-9 月期间：			1,569,830,130.68	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	集成电路制造用 300mm 硅片技术研发与产业化二期项目	集成电路制造用 300mm 硅片技术研发与产业化二期项目	1,750,000,000.00	1,599,072,851.27	884,513,194.42	1,750,000,000.00	1,599,072,851.27	884,513,194.42	-714,559,656.85	不适用
2	补充流动资金	补充流动资金	750,000,000.00	685,316,936.26	685,316,936.26	750,000,000.00	685,316,936.26	685,316,936.26		不适用
合计			2,500,000,000.00	2,284,389,787.53	1,569,830,130.68	2,500,000,000.00	2,284,389,787.53	1,569,830,130.68	-714,559,656.85	不适用